



8440 HS

Información Producto

40µm translucent HAF mounting tape

Descripción del producto

Características

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

Aplicación

tesa HAF® 8440 is especially designed for the embedding of chip-modules into smart cards.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | ninguno | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | copoliamida | • Espesor total | 40 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Fuerza de adhesión 12 N/mm²

Información adicional

Technical Recommendations:

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. This step can be performed inline or offline. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 130 - 140 °C
- Pressure 2 - 3 bar
- Time 2.5 m/min

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=08440>



8440 HS

Información Producto

Información adicional

2. Module Embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. For this step, the exact handling depends on the type of the implanting line used. Single step and multiple step can be used. Today, multiple step is common:

Single step process - Machine setting :

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

¹ Temperature as measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

*PVC 180 - 190 °C

*ABS 180 - 190 °C

*PC 200 - 220°C

For applicants other than chip module implanting, different machine parameters should be used.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is guaranteed clearance limit checked with each production batch (Material: Etched aluminium test specimen / Bonding conditions: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)

Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



8440 HS

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=08440>